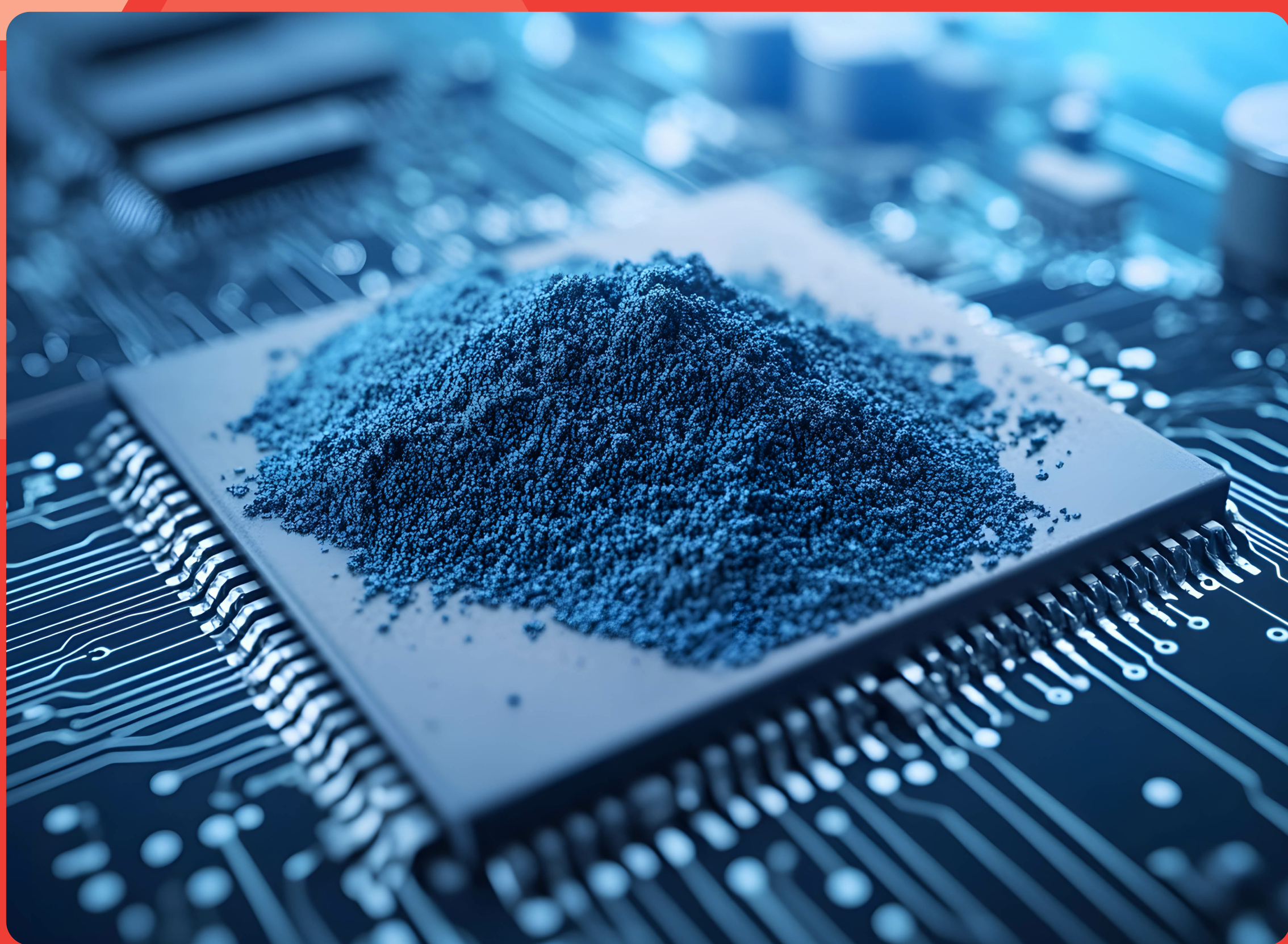


硅系列粉末

KCS·KCB系列 (开发中)

低介电聚合物·散热填料 添加剂

参
考
展
出



应用范围

- ◇ 低介电用途
半导体封装、封装材料、环氧封装材料、底填材料、阻焊剂、层间绝缘膜、预浸料
- ◇ 用于散热
汽车 / 功率器件用材料等
- ◇ 环氧、硅氧烷、丙烯酸等

- ① 低介电聚合物：低介电性、高耐热性
- ② 散热填料：散热性、流动性

① 低介电性、高耐热性 (复合粉末)

通过将低介电性聚合物颗粒添加到树脂中、有助于降低介电特性

产品型号	KCS-1
平均粒径	1μm
5%热分解温度 N2	290℃

※ 样品提供开始时间未定

② 散热性、流动性 (无机粉末)

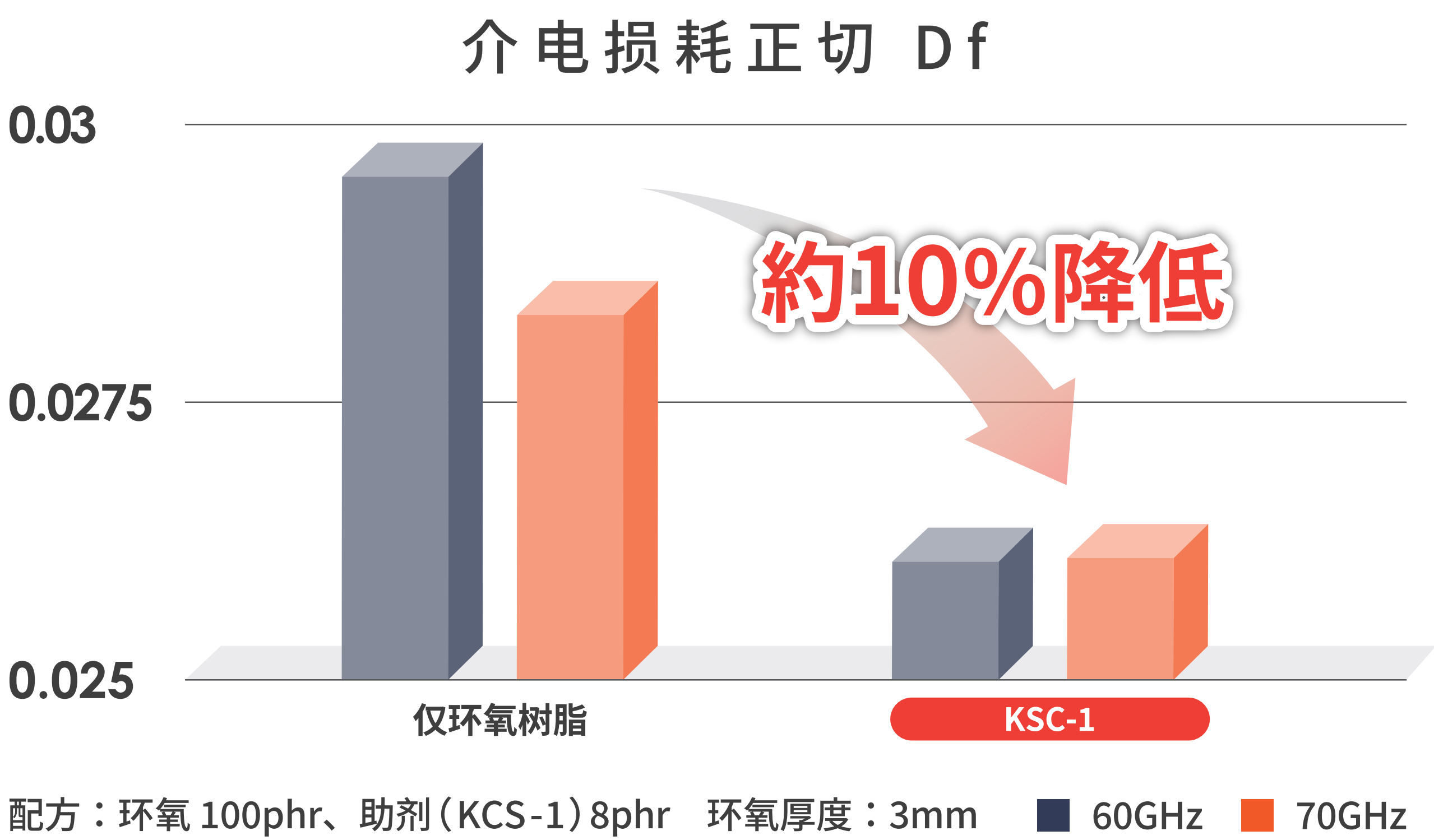
具有高散热性且流动性优异的粉末

氮化硼(BN)：面内方向的热导率大于200W/(m·K)

	BN	KCB-1	KCB-2
平均粒径	0.5μm	2μm	3μm

※ 样品提供开始时间未定

低介电性



流动性

